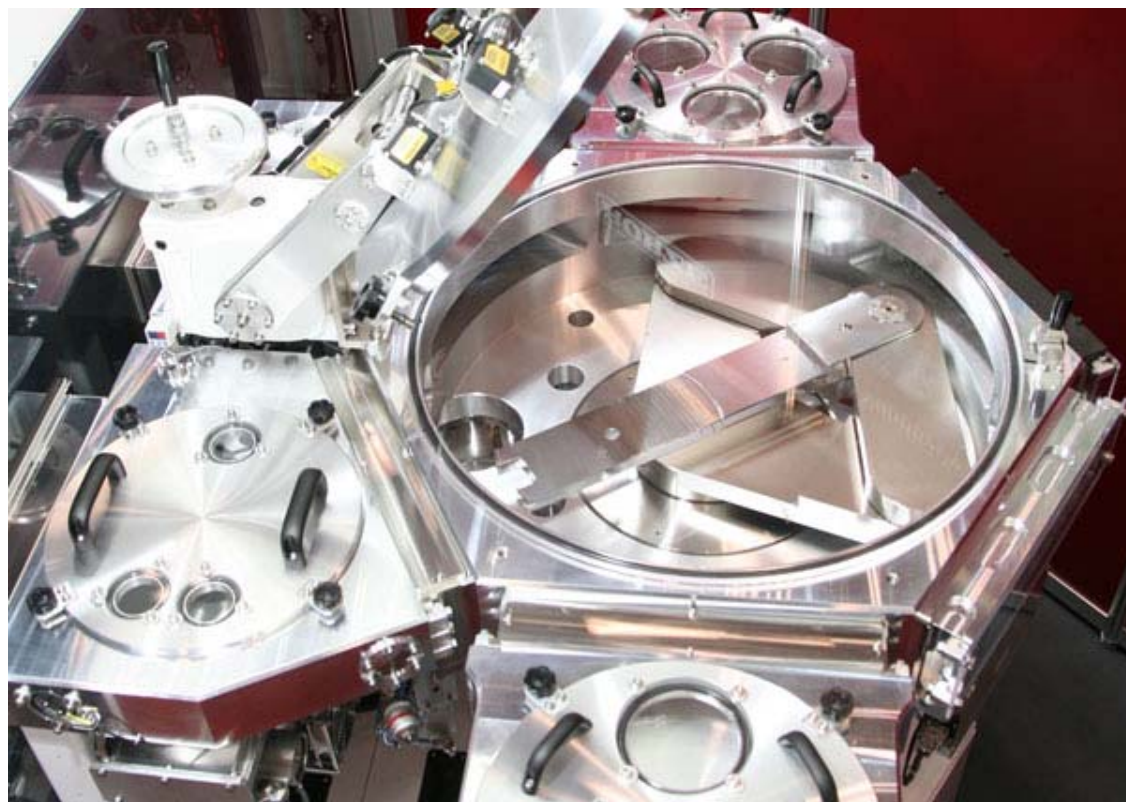
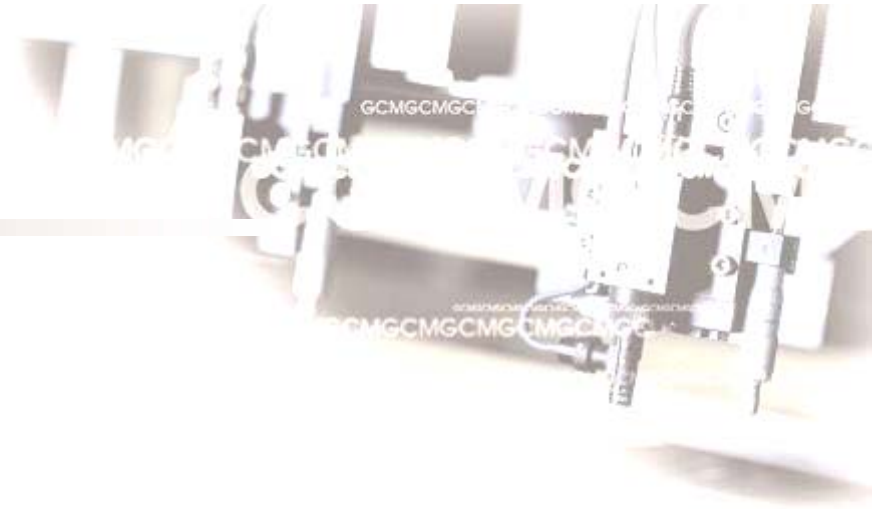


# 2009年2月期決算説明会資料



2009年4月20日  
**RORZE CORPORATION**



# 2009年2月期 決算概要

# 2009年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2008年2月期 実績	2009年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	13,569	8,377	△38.3%	【減少要因】 ・世界的な半導体設備投資の減少により、ウエハ搬送装置の受注が低調に推移 【増加要因】 ・韓国における液晶関係の積極的な設備投資によるガラス基板搬送装置の受注増加
売上総利益	3,987	1,836	△53.9%	【減少要因】 ・当社、並びに台湾・米国子会社の減収と、それに伴うベトナム生産子会社の生産量低下
販管費	2,157	1,681	△22.1%	【減少要因】 ・固定費削減 ・減収に伴う販売関連費用の減少
営業利益	1,829	154	△91.5%	
経常利益	1,806	152	△91.5%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純利益	1,298	△34	—%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

# 2009年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2008年2月期 実績	2009年2月期 実績	増減額	増減理由等
流動資産	12,964	8,805	△4,159	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現金及び預金 +396</li> <li>・受取手形及び売掛金 △2,579</li> <li>・棚卸資産 △1,196</li> <li>・その他 △579</li> </ul>
固定資産等	8,352	6,844	△1,507	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物及び構築物 △766</li> <li>・土地 △237</li> <li>・建設仮勘定 +107</li> <li>・投資有価証券 △175</li> <li>・投資その他の資産「その他」 △463</li> </ul>
資産合計	21,317	15,649	△5,667	
流動負債	8,053	5,571	△2,481	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支払手形及び買掛金 △477</li> <li>・短期借入金 △290</li> <li>・未払法人税等 △391</li> <li>・その他 △1,022</li> </ul>
固定負債	2,945	2,116	△828	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期借入金 △650</li> </ul>
負債合計	10,999	7,688	△3,310	
株主資本	8,425	8,186	△239	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利益剰余金 △211</li> </ul>
評価・換算差額等	248	△1,283	△1,532	<ul style="list-style-type: none"> <li>・為替換算調整勘定 △1,419</li> </ul>
少数株主持分	1,643	1,057	△585	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少数株主持分(主に韓国子会社) △585</li> </ul>
純資産合計	10,318	7,960	△2,357	
負債純資産合計	21,317	15,649	△5,667	

# 2009年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2008年2月期 実績	2009年2月期 実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	1,329	1,720	391
投資活動による キャッシュ・フロー	△476	△193	282
財務活動による キャッシュ・フロー	△263	△931	△668
現金及び現金同等物 に係る換算差額	△56	△322	△266
現金及び現金同等物 の減少額	533	272	△261
現金及び現金同等物 の期首残高	1,553	2,086	533
現金及び現金同等物 の期末残高	2,086	2,359	272

# 2009年2月期 単体損益計算書

(百万円)

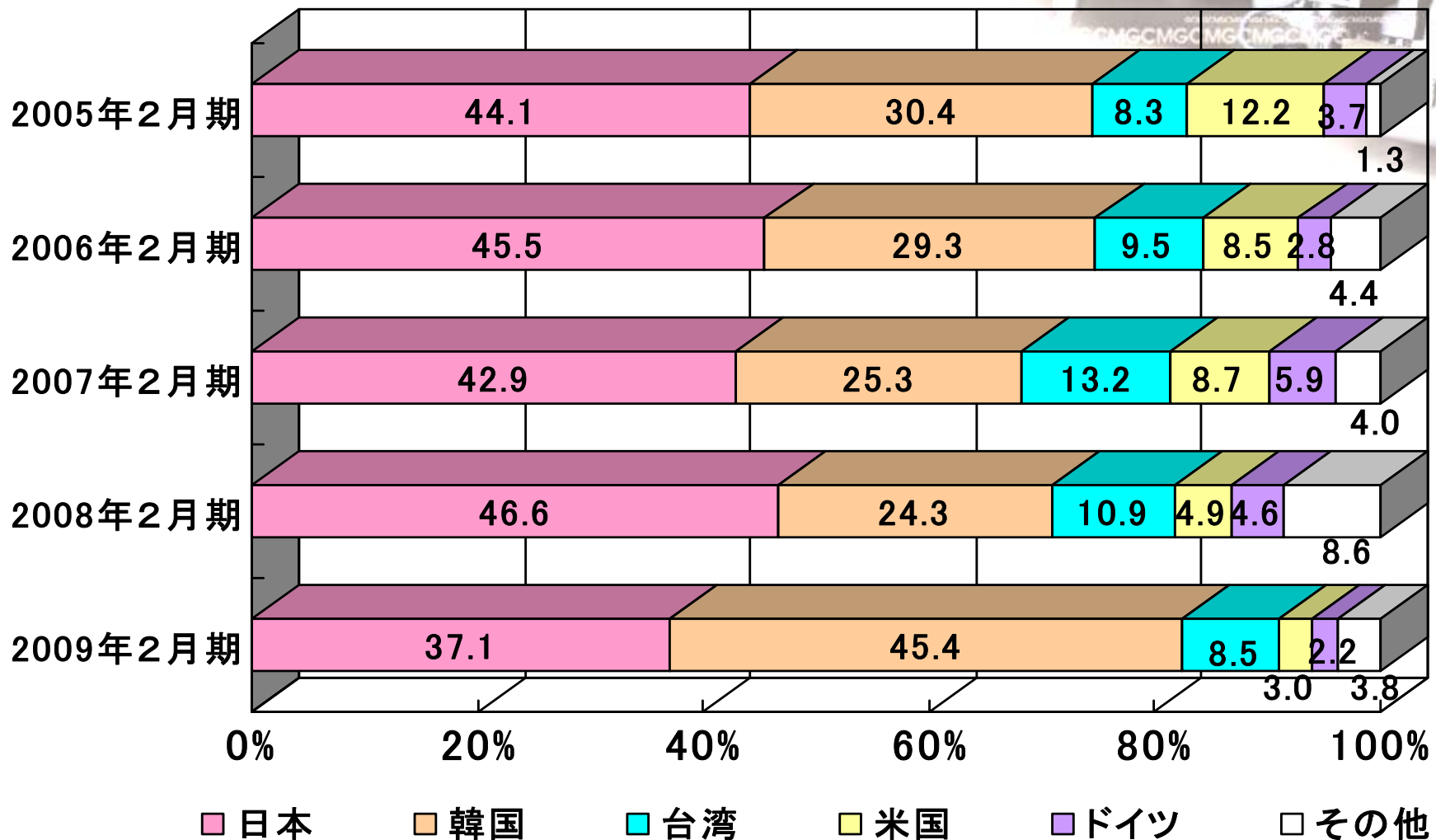
	2008年2月期 実績	2009年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	9,716	4,005	△58.8%	【減少要因】 ・主に、国内の半導体設備投資計画の先送りや凍結による受注低迷
売上総利益	2,353	882	△62.5%	【減少要因】 ・売上減少
販管費	1,076	837	△22.2%	【減少要因】 ・固定費削減 ・減収に伴う販売関連費用の減少
営業利益	1,277	45	△96.4%	
経常利益	1,243	35	△97.1%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純利益	726	3	△99.6%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

# 2009年2月期 単体貸借対照表

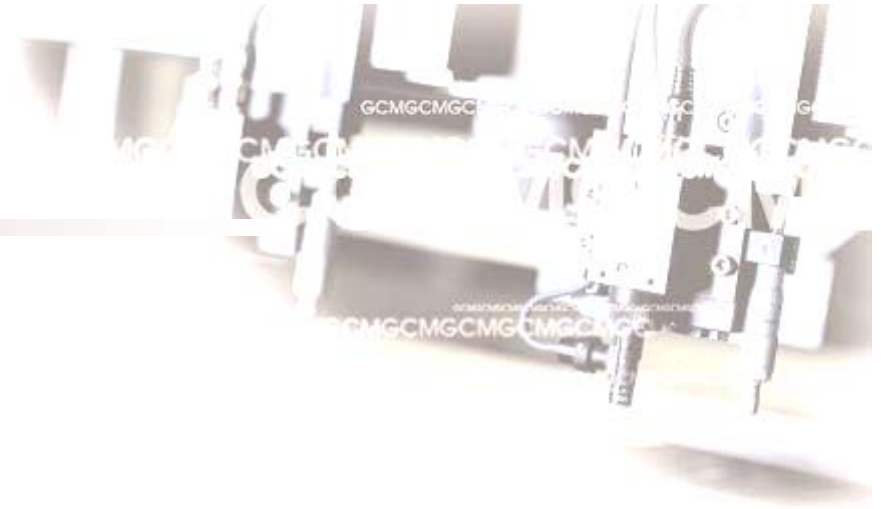
(百万円)

	2008年2月期 実績	2009年2月 期実績	増減額	増減理由等
流動資産	8,188	5,619	△2,569	・現金及び預金 +339 ・受取手形及び売掛金 △2,467 ・棚卸資産 △334
固定資産	7,809	8,142	332	・関係会社長期貸付金 +382
資産合計	15,998	13,761	△2,236	
流動負債	6,385	4,838	△1,546	・支払手形及び買掛金 △712 ・短期借入金 △208 ・未払法人税等 △318
固定負債	2,132	1,756	△375	・長期借入金 △390
負債合計	8,517	6,595	△1,921	
株主資本	7,340	7,138	△201	・別途積立金 +500 ・繰越利益剰余金 △673
評価・換算差額等	141	28	△113	・その他有価証券評価差額金 △113
純資産合計	7,481	7,166	△314	
負債純資産合計	15,998	13,761	△2,236	

# 海外売上高(連結)

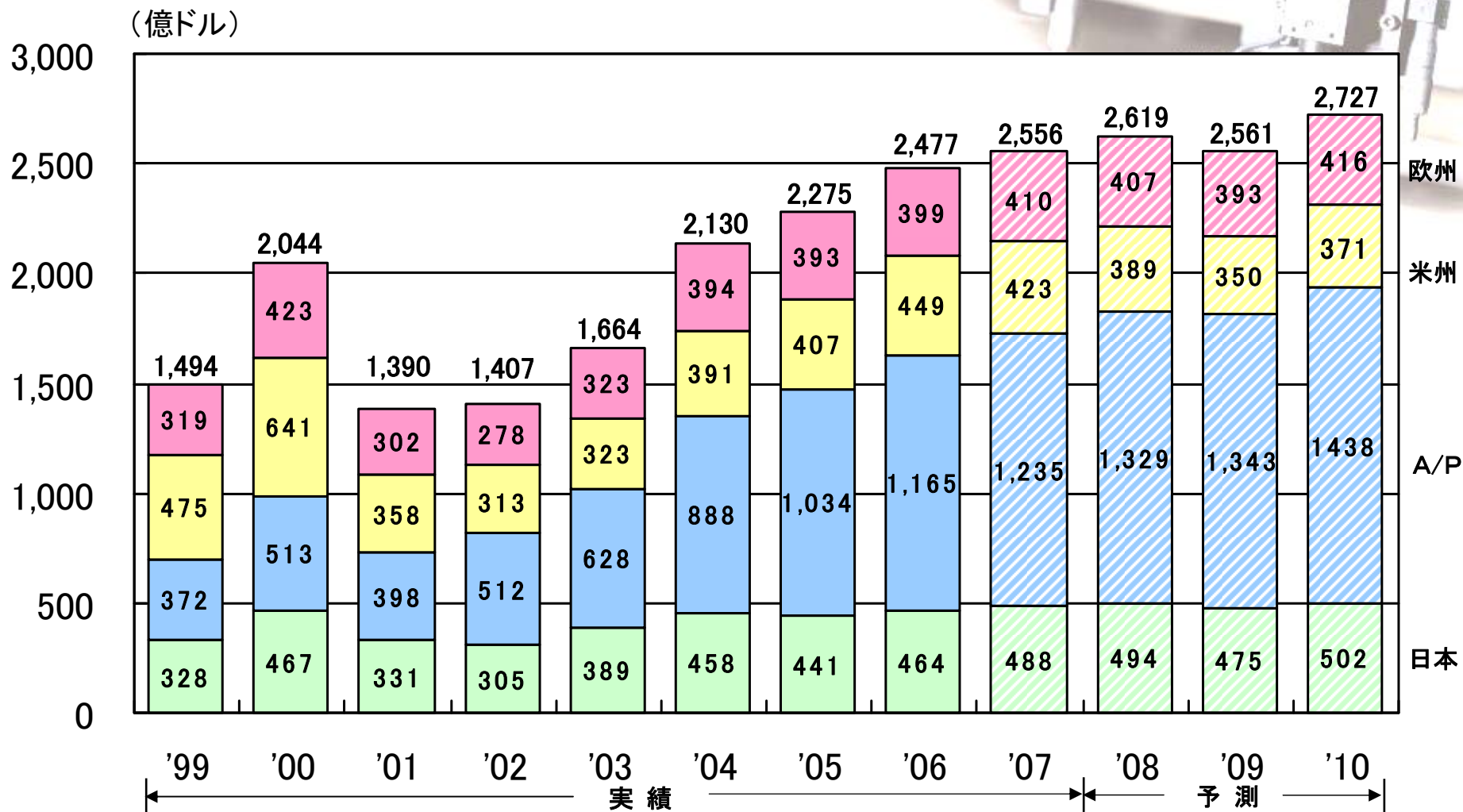






## 2010年2月期 業績予想

# 世界の地域別半導体市場規模

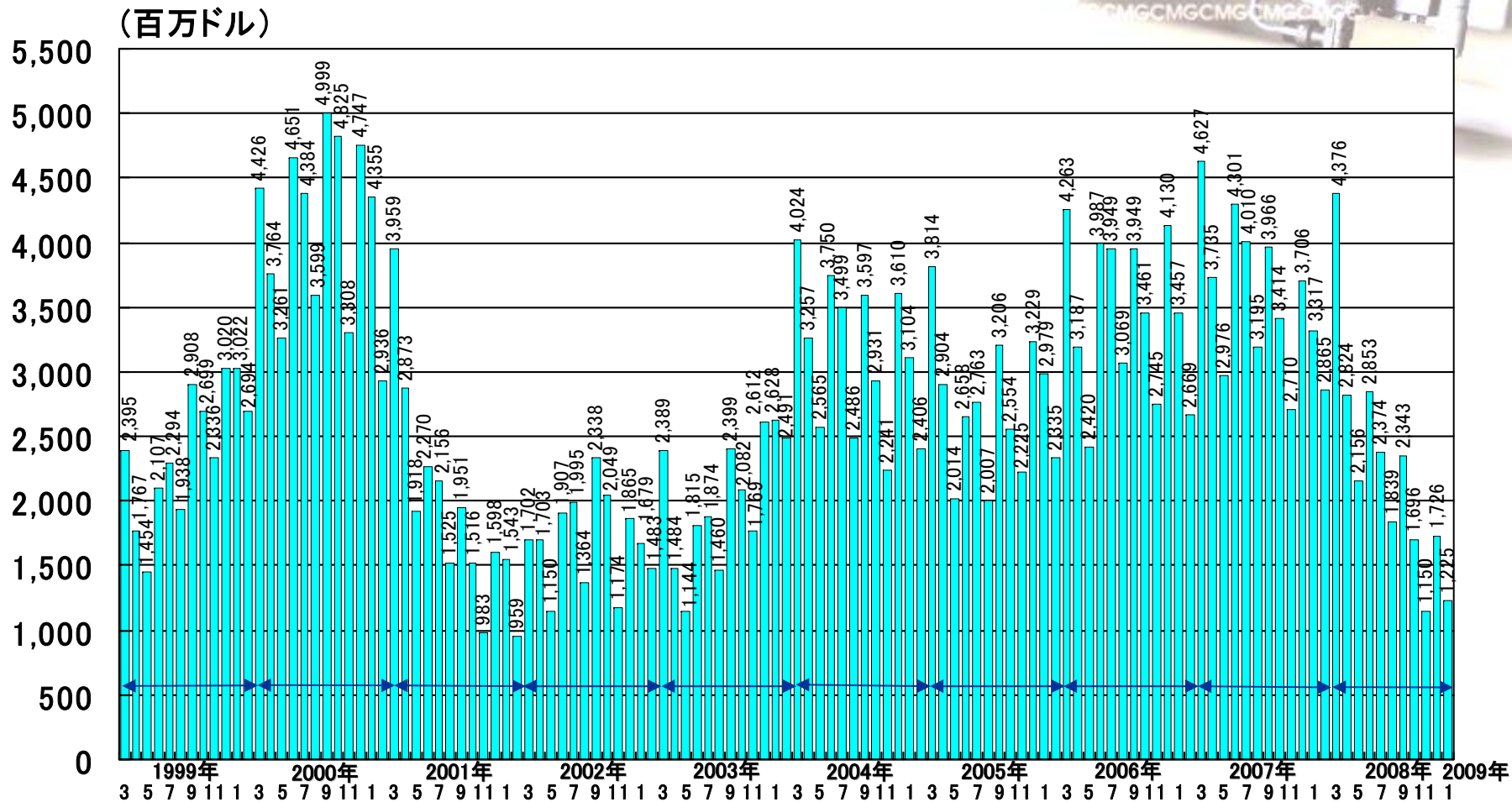


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2008年11月19日付 電波新聞) (2008年11月 WSTS発表)

# 世界規模 半導体製造装置販売統計

(2009年1月末現在)



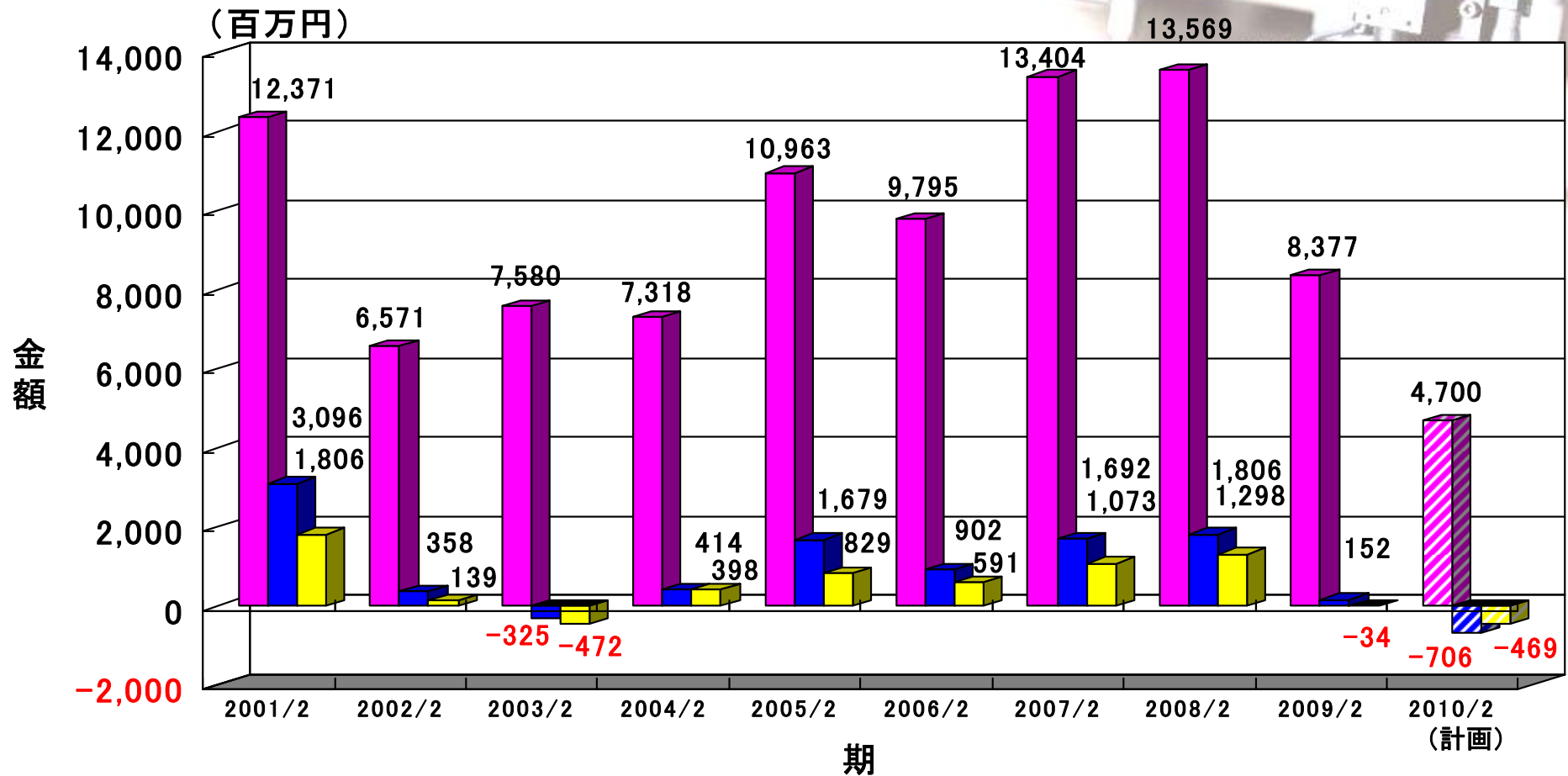
(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

# 2010年2月期 連結業績予想

(百万円)

	2009年2月期 実績	2010年2月期 予想	増減率
売上高	8,377	4,700	△43.9%
売上総利益	1,836	735	△60.0%
販管費	1,681	1,401	△16.7%
営業利益	154	△666	—%
経常利益	152	△706	—%
当期純利益	△34	△469	%

# 連結業績の推移と今期計画



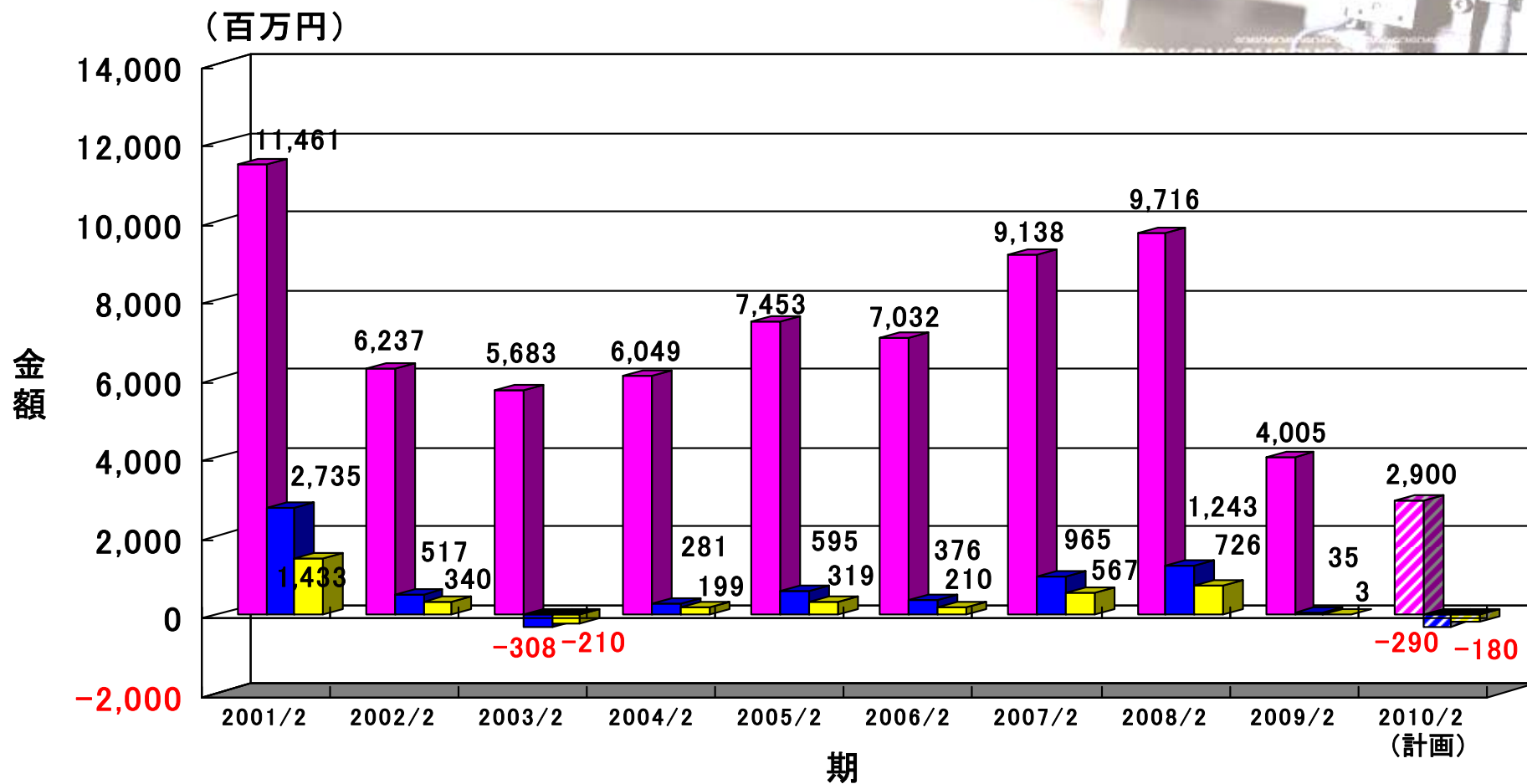
■ 売上高(実績)     
 ■ 経常損益(実績)     
 ■ 当期純損益(実績)

# 2010年2月期 単体業績予想

(百万円)

	2009年2月期 実績	2010年2月期 予想	増減率
売上高	4,005	2,900	△27.6%
売上総利益	882	541	△38.6%
販管費	837	790	△5.6%
営業利益	45	△248	—%
経常利益	35	△290	—%
当期純利益	3	△180	—%

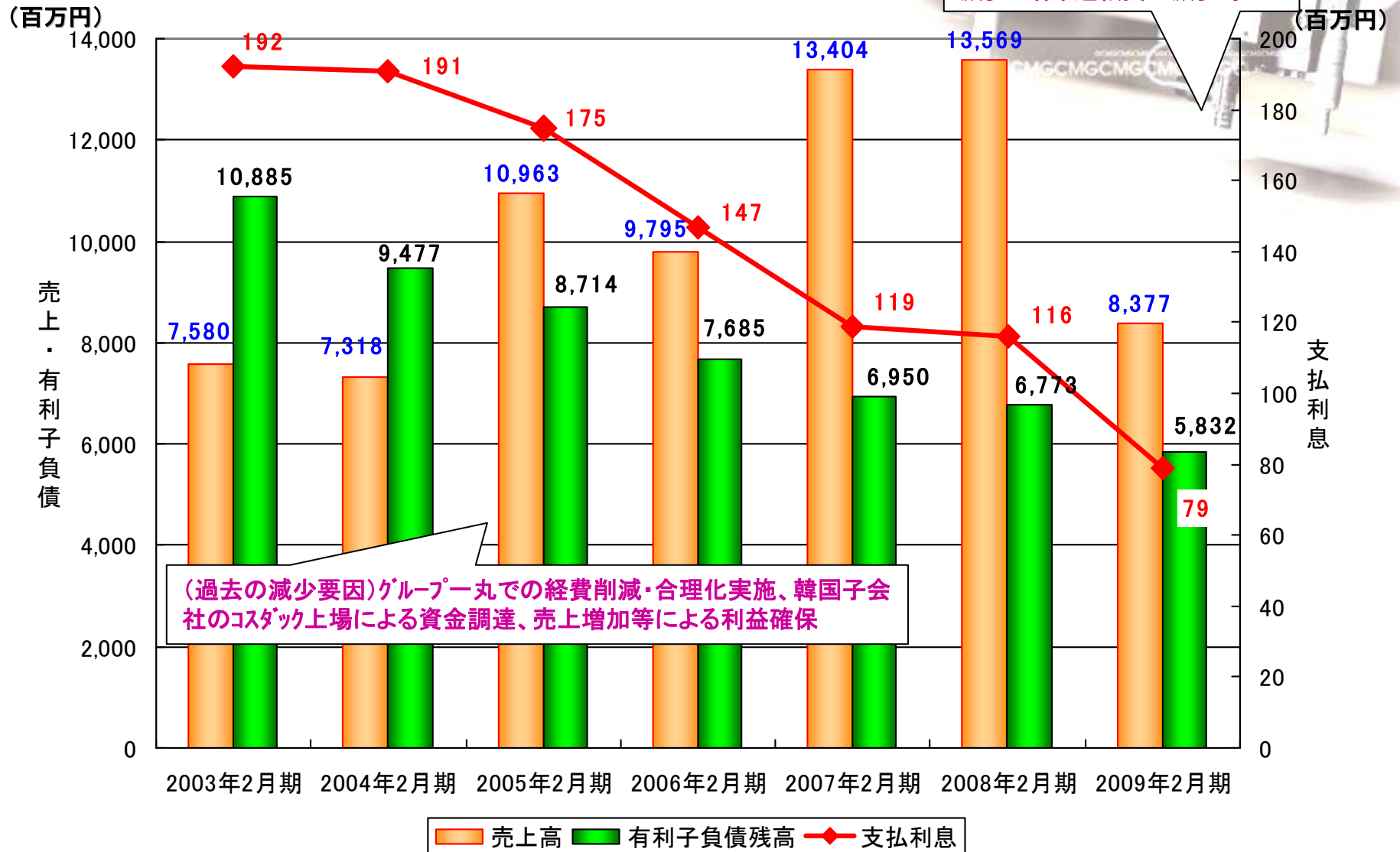
# 単体業績の推移と今期計画



■ 売上高(実績)    
 ■ 経常損益(実績)    
 ■ 当期純損益(実績)

# 有利子負債残高の減少

(2009年2月期減少要因)  
 売掛債権の順調な回収、受注減少に伴う運転資金減少等





# 本日はありがとうございました

## 注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。